タツモ株式会社　決算説明資料

2022年12月期第2四半期

2022年8月10日発表

タツモ株式会社

© 2020 TAZMO Co., Ltd. All Right Reserved.

会社概要

社名	タツモ株式会社
設立	1972年（昭和47年）2月26日
本社所在地	岡山県岡山市北区芳賀5311
資本金	34億9,540万538円
従業員数	単体 359名/連結 1,103名（2022年6月30日現在）
事業内容	半導体製造装置、半導体製造用搬送装置、液晶製造装置、紫外線照射装置、めっき処理装置、精密金型・樹脂成型品などの開発・製造・販売

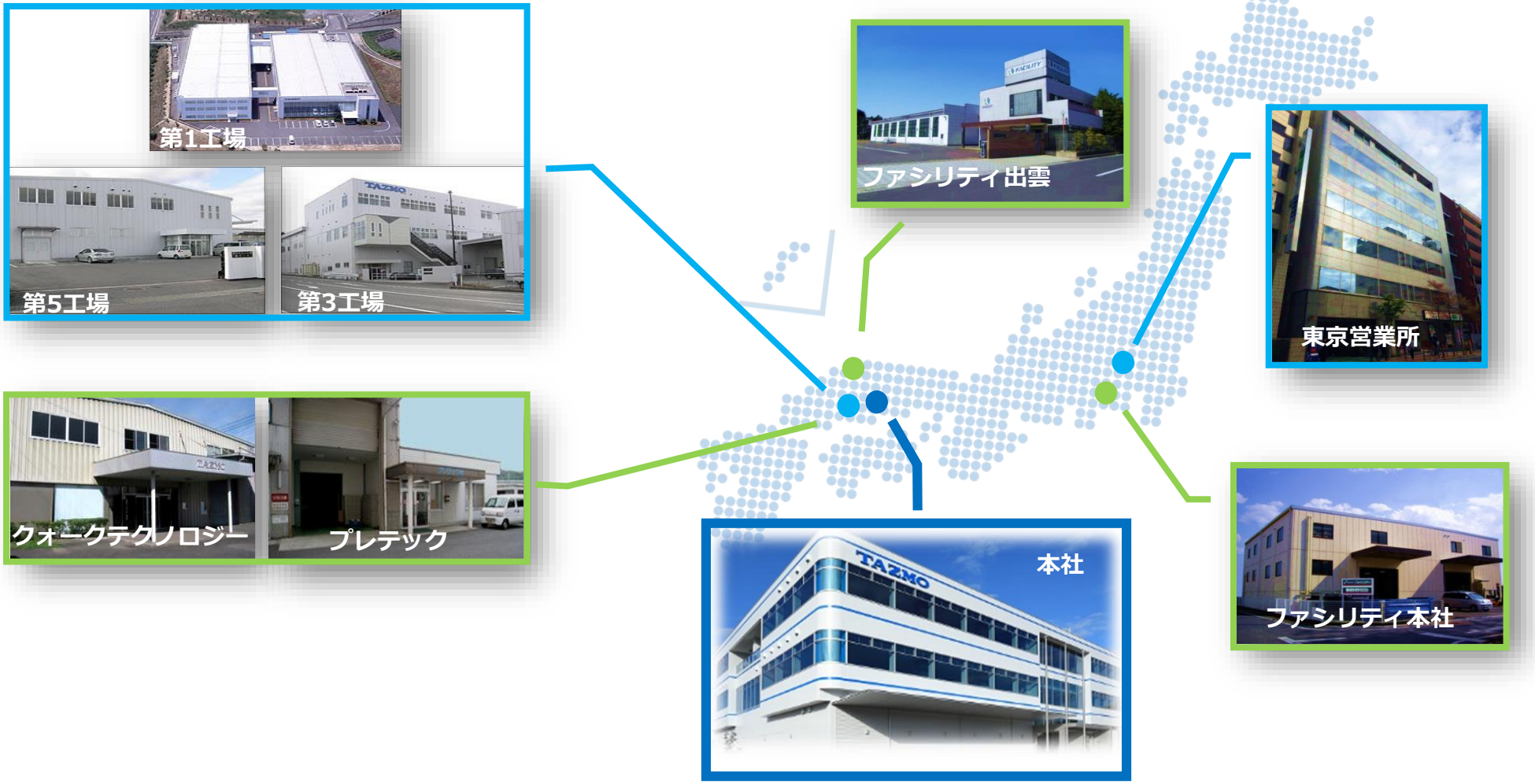
沿革

1972	電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として設立
1980	インジェクション金型他、金型の製造・販売を開始
	半導体製造用全自動レジスト塗布装置を開発、製造・販売を開始
1989	液晶用カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
1990	本社・本社工場を新築、岡山県井原市木之子町6186番地に移転
	ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝﾙｰﾑ用超小型搬送システムを開発、製造・販売を開始
1994	エンボスキャリアテープの製造・販売を開始
1995	インジェクション成形品の製造・販売を開始
2001	半導体製造用厚膜コーター「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始
2004	JASDAQ市場に株式を上場
2008	TAZMO VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム：ホーチミン市）を設立

沿革

2009	第１０世代対応カラーフィルター製造装置を開発、製造・販売を開始
	３Ｍ社（米国）と半導体製造装置のライセンス契約を締結
2013	アプリシアテクノロジー株式会社を子会社化
	ﾛﾝｱﾝ省ﾛﾝﾊｳ工業団地内にTAZMO VIETNAM CO.,LTD.を移転・新築
2015	第三者割当増資により、資本金16億1,683万円へ増資
2016	タツモ岡山技術センターを開設
2017	株式会社ファシリティ、株式会社クォークテクノロジーを子会社化
2018	東京証券取引所市場第一部へ市場変更
	新株式発行により、資本金27億2,406万円へ増資
2019	本社を岡山県岡山市北区芳賀5311番地に移転
2020	アプリシアテクノロジー株式会社を吸収合併
2022	公募増資により、資本金34億9,540万538円へ増資

国内拠点・関連子会社


第1工場
第5工場
第3工場
ファシリティ出雲
東京営業所
クォークテクノロジー
プレテック
本社
ファシリティ本社

海外拠点

TAZMO

富莱得科技(東莞)有限公司

富莱得(香港)有限公司

TAZMO INC

TAZMO VIETNAM CO.,LTD

FACILITY HANOI CO.,LTD.

龍雲阿普理夏电子科技有限公司

上海龍雲精密機械有限公司

龍雲亞普恩科技股份有限公司

セグメント紹介

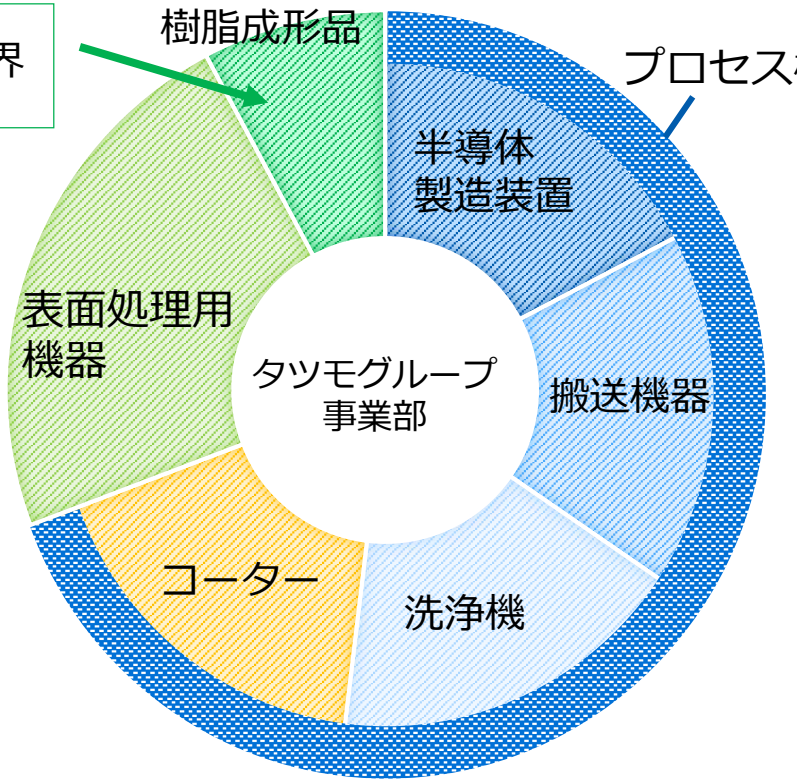
プレテック株式会社

金型・樹脂成形品業界

株式会社ファシリティ

PCB業界

※PCB：電子回路基盤



タツモ株式会社

半導体製造装置業界
FPD製造装置業界

※FPD：フラットパネルディスプレイ

半導体製造装置、搬送ロボット、液晶製造装置、精密金型、樹脂成形品、めっき処理装置等の開発・製造・販売

事業紹介

TAZMO

半導体製造装置事業

半導体製造に用いられる薬液の塗布・現像装置や、
シリコンウェーハ薄化のために支持体とウェーハを
仮接合・剥離する装置等の開発・製造・販売

搬送機器事業

半導体製造装置に用いられるシリコンウェーハ等搬送ロボットや
アライメント機器、またそれらをユーザー別の仕様にユニット化した
製品等の開発・製造・販売

洗浄装置事業

半導体製造に用いられるシリコンウェーハ洗浄装置や、
スラリーの供給装置、リン酸再生装置などの開発・製造・販売

事業紹介

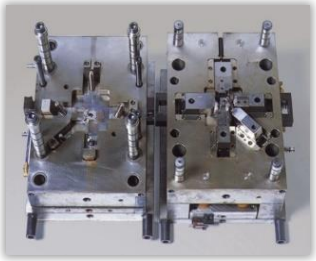
TAZMO

コーター事業

液晶カラーフィルター製造装置向けを中心としたガラス基板への薬液塗布装置の開発･製造・販売

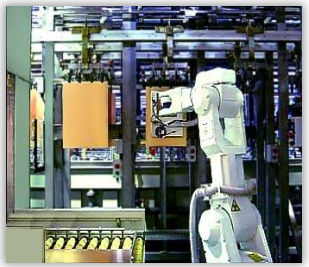
金型・樹脂成形品事業

電子機器部品用の金型の製作及び、その金型を使ったコネクター等の樹脂成形品、エンボスキャリアテープの製造・販売



表面処理用機器事業

めっき処理装置や回路形成装置等のプリント基板製造装置等の開発・製造・販売



連結業績

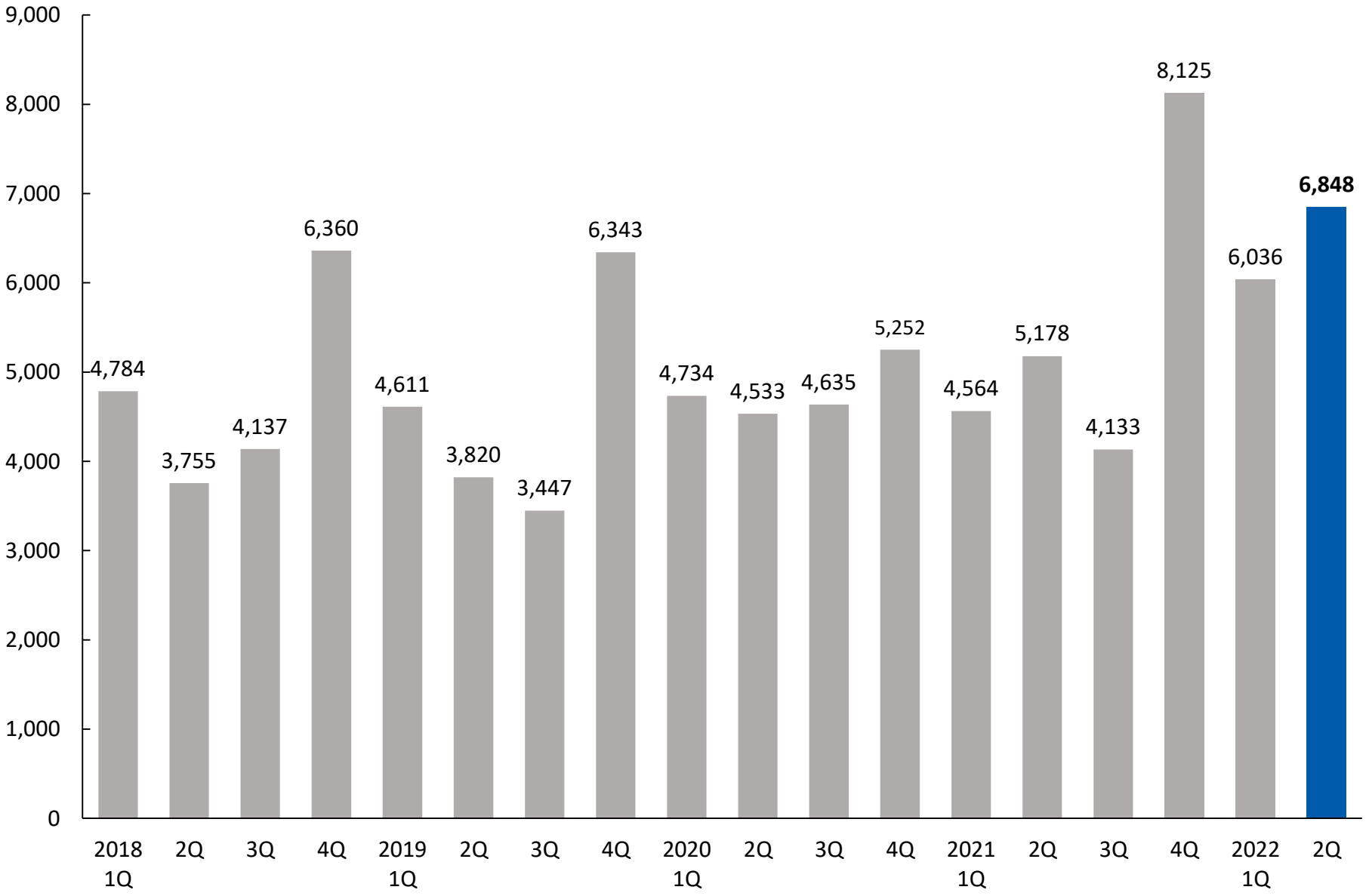
TAZMO

単位:百万円	'21年 2Q	'22年 2Q	売上比 (%)	今期計画 (修正後通期)	達成率 (%)
売上高	9,742	12,885	–	26,133	49.3
売上総利益	2,581	3,469	26.9	–	–
販管費	1,835	2,180	16.9	–	–
営業利益	746	1,289	10.0	2,988	43.1
経常利益	821	1,725	13.4	3,396	50.8
親会社株主に帰属する四半期純利益	552	1,246	9.7	2,412	51.7

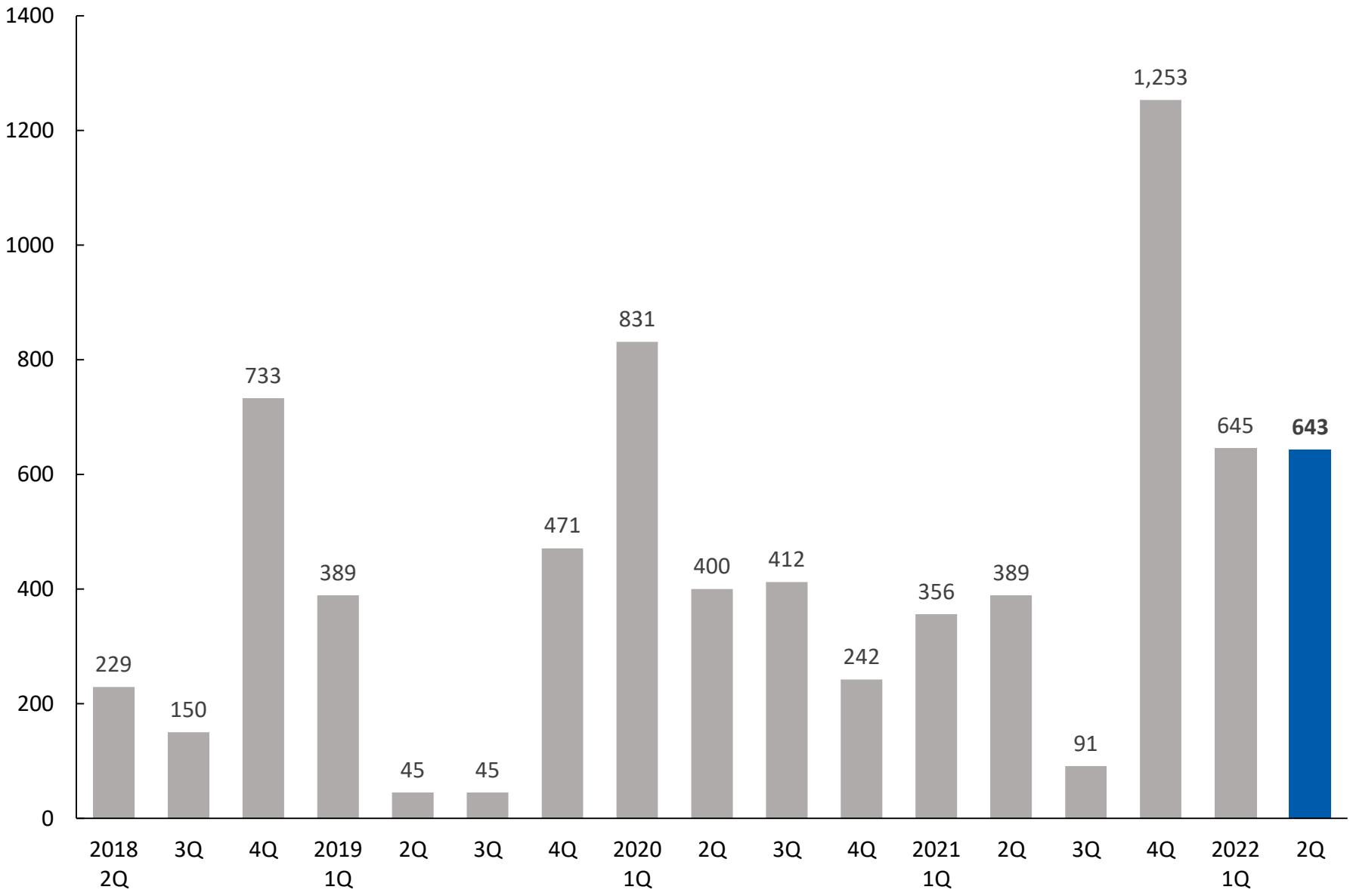
半導体製造装置の検収前倒し、コーターの前期未検収分の売上計上および搬送装置部門の売上が堅調に推移し、売上高は年初計画を上回る結果となった。

半導体製造装置、搬送装置の売上増加およびベトナム子会社が堅調に推移し、原価低減活動の効果もあり営業利益も年初計画を上回る結果となった。

連結売上高推移


9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
4,784
3,755
4,137
6,360
4,611
3,820
3,447
6,343
4,734
4,533
4,635
5,252
4,564
5,178
4,133
8,125
6,036
6,848
2018 1Q
2Q
3Q
4Q
2019 1Q
2Q
3Q
4Q
2020 1Q
2Q
3Q
4Q
2021 1Q
2Q
3Q
4Q
2022 1Q
2Q

連結営業利益推移


1400
1200
1000
800
600
400
200
0
229
150
733
389
45
45
471
831
400
412
242
356
389
91
1,253
645
643
2018 2Q
3Q
4Q
2019 1Q
2Q
3Q
4Q
2020 1Q
2Q
3Q
4Q
2021 1Q
2Q
3Q
4Q
2022 1Q
2Q

連結貸借対照表

TAZMO

単位：百万円	‘21年12月期	‘22年2Q	増減
流　動　資　産	22,075	27,363	5,287
有形固定資産	5,870	6,194	323
無形固定資産	147	199	52
投資その他資産	1,295	1,299	3
総　資　産	29,390	35,057	5,667
流　動　負　債	13,457	14,148	690
固　定　負　債	2,357	4,080	1,722
純　資　産	13,574	16,828	3,253
自己資本比率	45.5%	47.2%	1.7P

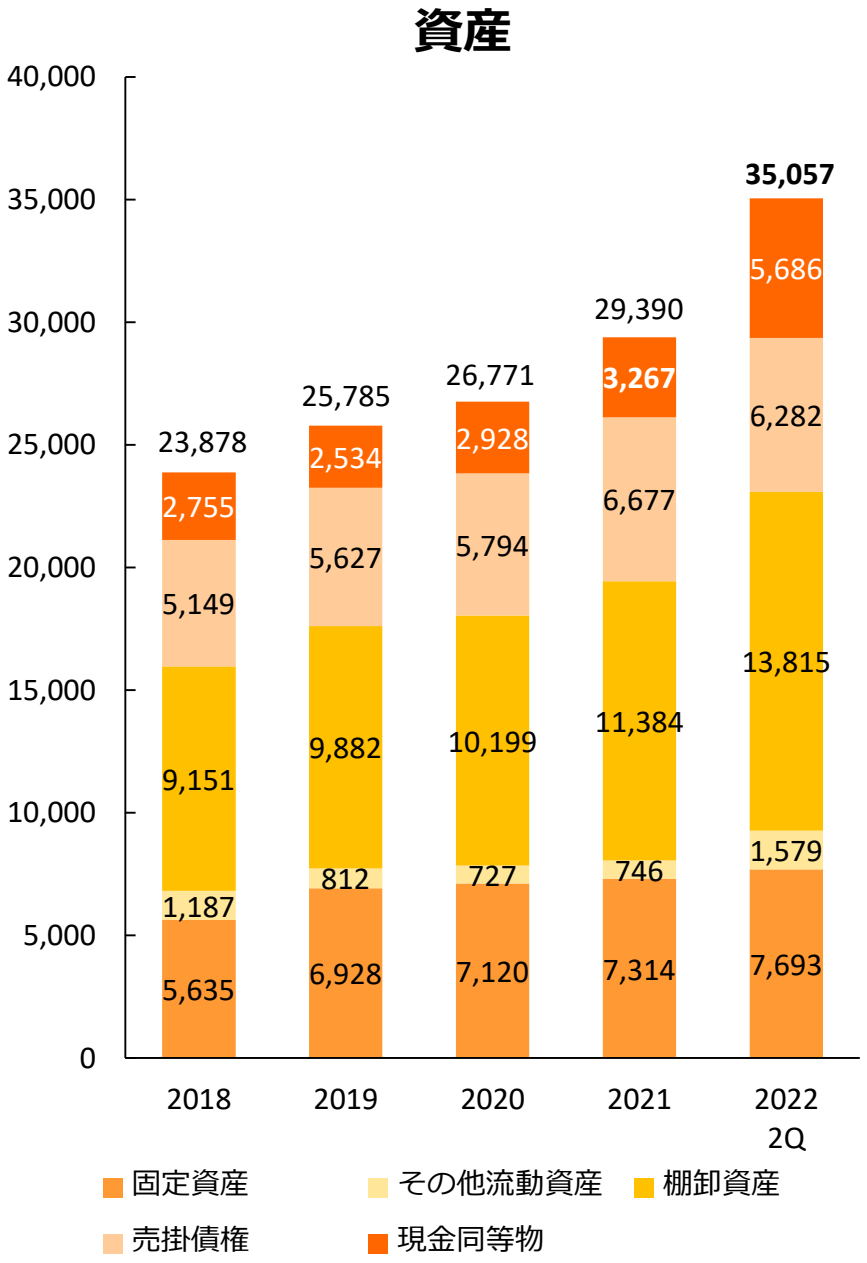
連結貸借対照表　主な増減

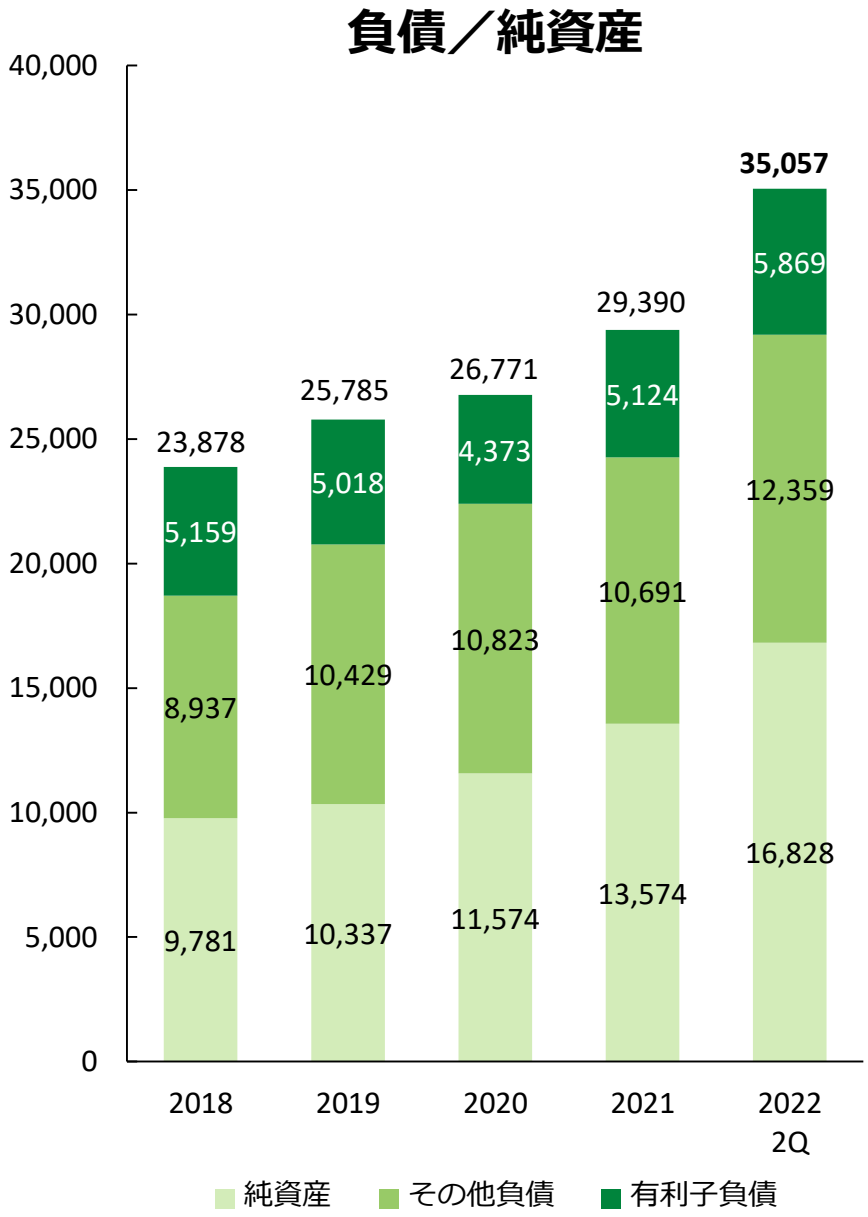
TAZMO

主な増減		
資産		
	‘22年2Q	前期末比
現金及び預金	5,686	2,418
受取手形及び売掛金	4,816	△658
電子記録債権	1,465	263
棚卸資産	13,815	2,430
負債		
	‘22年2Q	前期末比
支払手形及び買掛金	2,206	332
電子記録債務	4,153	1,665
短期借入金	2,539	△632
前受金（契約負債）	2,440	930
長期借入金	3,330	1,677

資産・負債／純資産推移

単位：百万円





セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円	’21年 2Q	’22年 2Q	売上比（%）	今期計画（修正後通期）	達成率（%）
売上高	**9,742**	**12,885**	**–**	**26,133**	**49.3**
プロセス機器事業	**7,416**	**9,977**	**77.4**	**20,295**	**49.2**
半導体装置	1,595	2,709	21.0	6,069	44.6
搬送機器	2,772	3,479	27.0	6,796	51.2
洗浄機	1,283	1,229	9.5	3,350	36.7
コーター	1,765	2,558	19.9	4,080	62.7
金型・樹脂成形事業	**763**	**815**	**6.3**	**1,701**	**47.9**
表面処理用機器事業	**1,562**	**2,091**	**16.2**	**4,137**	**50.5**

半導体装置：装置検収の前倒し等により、前年同期比で69.8%増

搬送機器　：引き続き受注好調　ベトナム子会社も好調に推移　前年同期比25.5%増

洗浄機　　：おおむね計画通りに推移　前年同期比4.2%減

コーター　：’21年未検収分の売上計上により、前年同期比44.9%増

表面処理用機器：検収遅れ等により計画未達となった　前年同期比33.9%増

セグメント別業績

TAZMO

単位：百万円	’21年 2Q	’22年 2Q	売上比 (%)	今期計画 （修正後通期）	達成率 (%)
営業利益	**746**	**1,289**	**10.0**	**2,988**	**43.1**
プロセス機器事業	656	1,163	9.0	2,750	42.3
金型・樹脂成形事業	53	27	0.2	57	47.4
表面処理用機器事業	40	101	0.8	180	56.1
セグメント間連結消去	△4	△2	–	–	–

プロセス機器事業　：半導体装置および搬送装置の売上増加により　前年同期比77.3%増

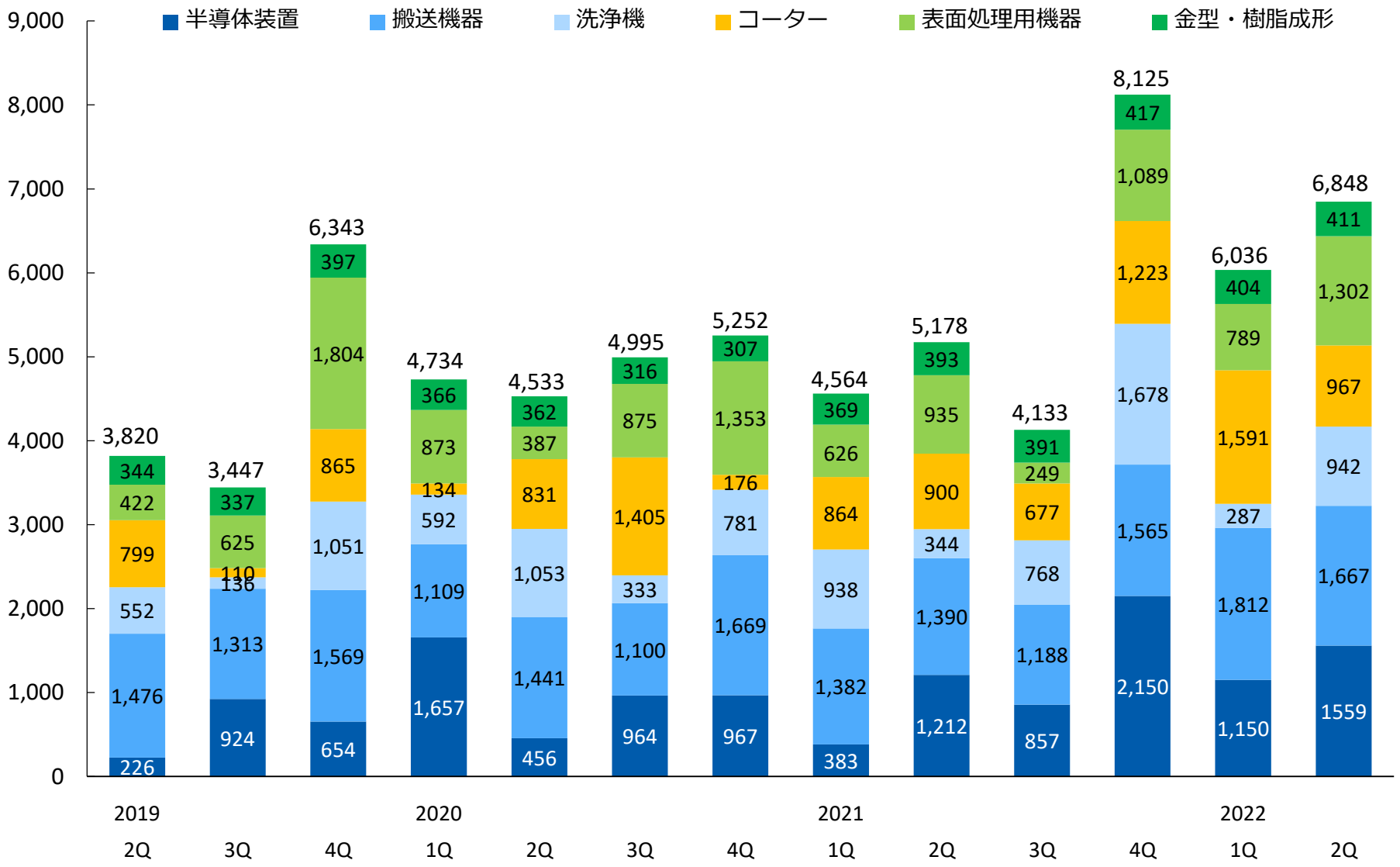
金型・樹脂成形事業：上海子会社のロックダウンおよび材料費の高騰により　前年同期比48.7%減

表面処理用機器事業：プリント基板メーカーの設備投資が回復傾向にあり　前年同期比147.6%増

セグメント別　売上高推移

TAZMO

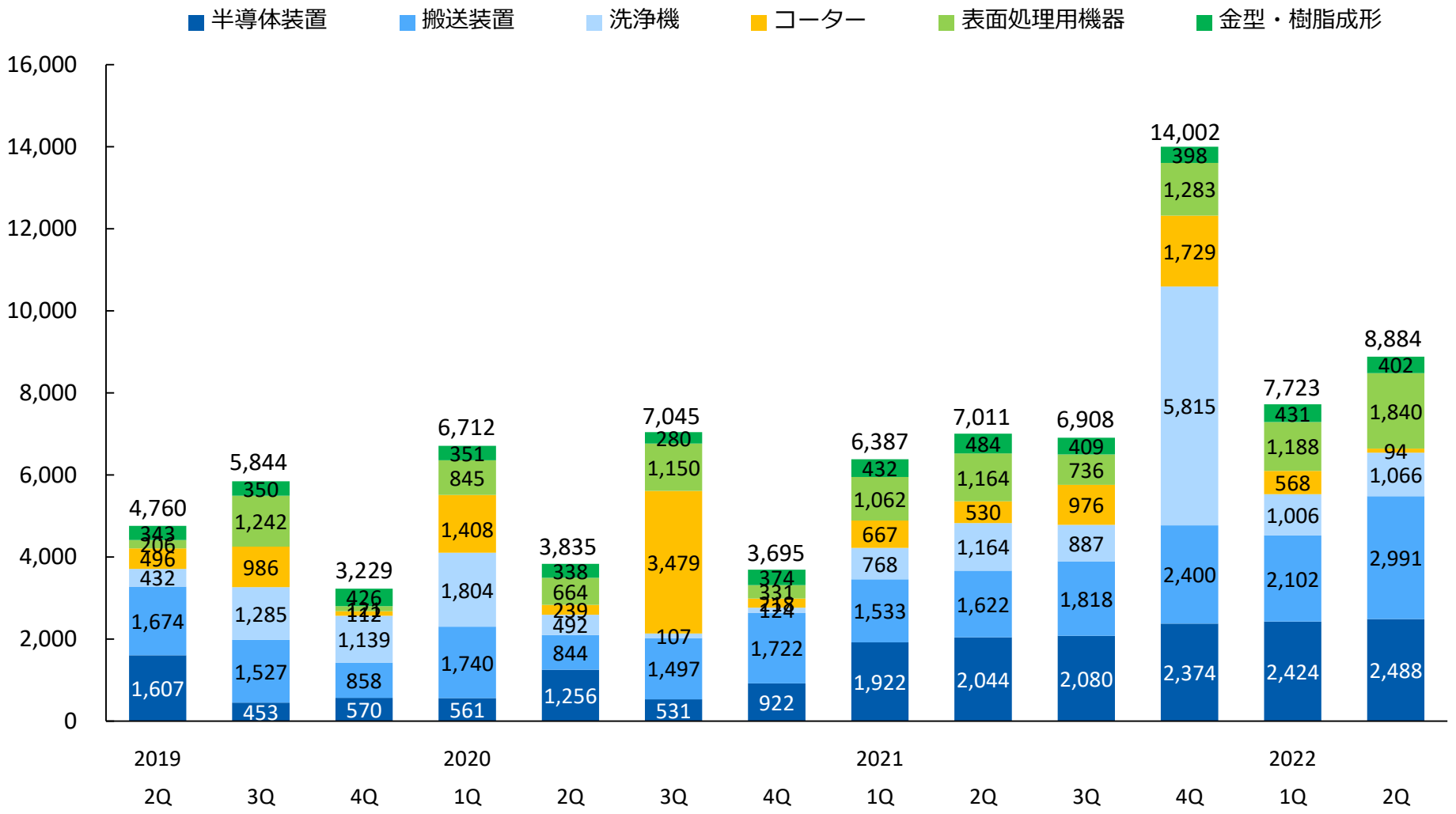
単位：百万円



セグメント別　受注高推移

TAZMO

単位：百万円



プロセス機器事業　：半導体装置及び搬送機器の受注好調。強い引合が継続中。

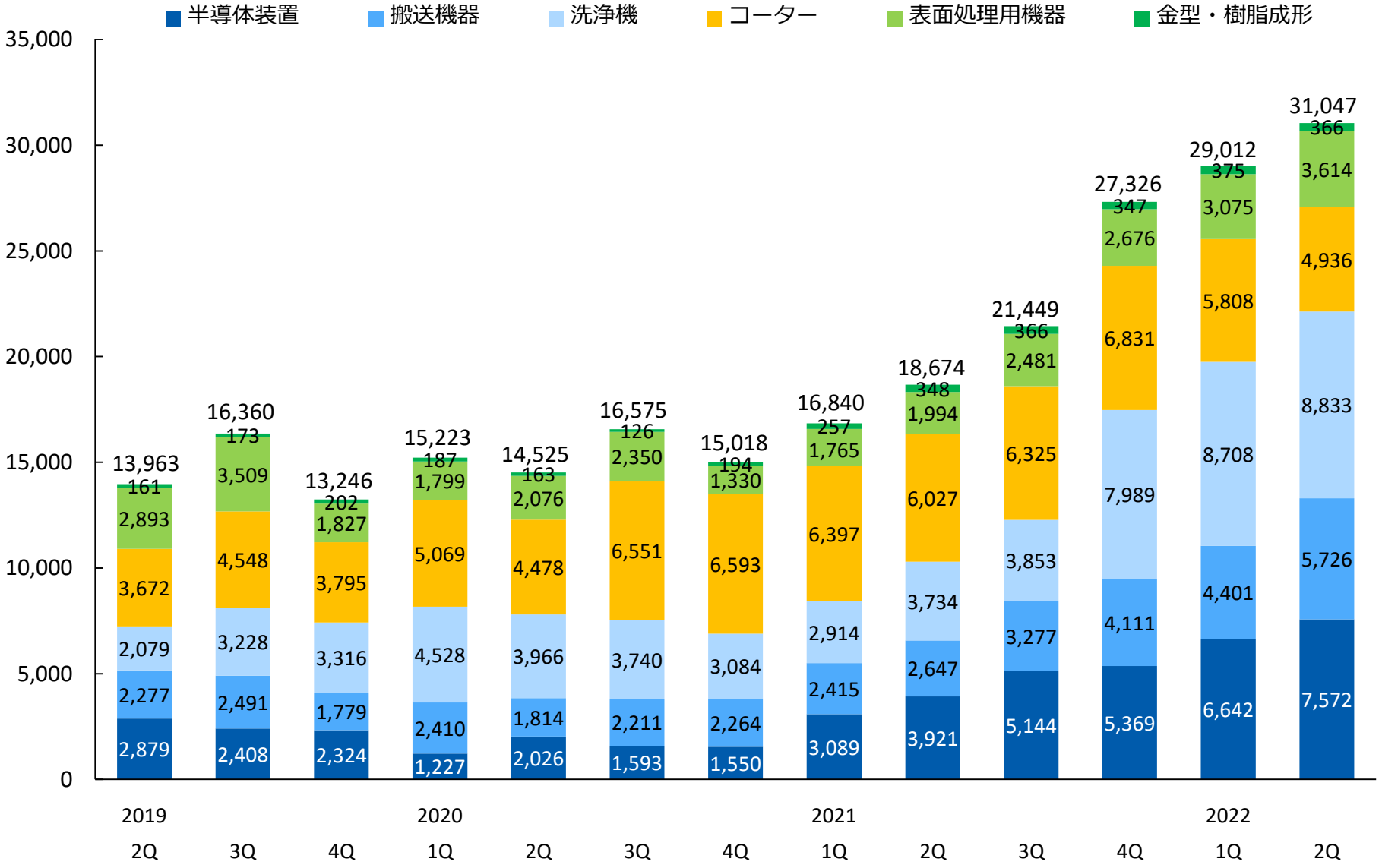
表面処理用機器事業：引合・受注が回復傾向。

金型・樹脂成形事業：コネクター関係の受注好調。

セグメント別　受注残高推移

TAZMO

単位：百万円



- パワー半導体向け半導体製造装置の受注・引合は引続き好調。パワー半導体向け以外の半導体製造装置は納期調整の話も出てきている。
- 搬送装置も受注・引合は好調。メモリー、ロジックの設備投資に陰りが見え始めているため、今後の展開に注意が必要。
- 表面処理用機器事業では引合が回復。確実な受注を目指す。
- 金型・樹脂成形では原材料の高騰により利益率悪化。価格交渉により今後は利益率改善の見通し。
- 一部の部品では調達状況が徐々に回復してくるとの話もあるが、全体的には引き続き調達困難な状況。代替品も検討し対応中。

注意事項

本資料の取扱上の注意

本資料は、2022年8月10日発表の決算短信に基づいて作成されております。

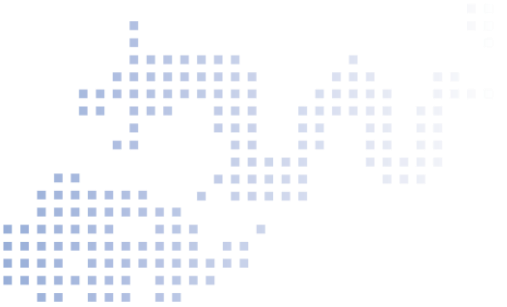
また、本資料に記載されている業績予測等は、現在入手可能な情報に基づいて作成されたものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

掲載内容には細心の注意を払っておりますが、掲載された内容に基づいて被った損害については、弊社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

本資料に関するお問い合わせ先

タツモ株式会社　経営企画室

TEL　086-239-5000
FAX　086-239-5100
Email　keiki@tazmo.co.jp



© 2020 TAZMO Co., Ltd. All Right Reserved.